

2024-2029年中国半导体测试板行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：半导体测试板行业综述及数据来源说明

1.1 集成电路（IC）行业界定

- 1.1.1 集成电路（IC）的界定
- 1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中集成电路（IC）行业归属
- 1.1.3 集成电路（IC）产业链
 - （1）芯片设计
 - （2）晶圆制造
 - （3）封装测试
 - 1) IC封装基板
 - 2) IC测试板（半导体测试板）（本报告研究对象）
 - （4）IC产品应用
- 1.1.4 半导体测试板应用于半导体封装测试各流程

1.2 半导体测试板行业界定

- 1.2.1 半导体测试板的界定
- 1.2.2 半导体测试板的类型
 - （1）探针卡（Probe Card）
 - （2）测试负载板（Load Board）
 - （3）老化测试板（Burn in Board）
 - （4）中介层（Interposer）

1.3 半导体测试板专业术语说明

1.4 本报告研究范围界定说明

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

- 1.5.1 本报告权威数据来源
- 1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明

第2章：中国半导体测试板行业技术及政策环境分析

2.1 中国半导体测试板行业技术（Technology）环境分析

- 2.1.1 中国半导体测试板行业工艺/技术路线分析
- 2.1.2 中国半导体测试板行业关键技术分析
- 2.1.3 中国半导体测试板行业科研投入状况（研发力度及强度）
- 2.1.4 中国半导体测试板行业科研创新成果（专利、科研成果转化等）
 - （1）中国半导体测试板行业专利申请
 - （2）中国半导体测试板行业专利公开
 - （3）中国半导体测试板行业热门申请人
 - （4）中国半导体测试板行业热门技术
- 2.1.5 技术环境对半导体测试板行业发展的影响总结

2.2 中国半导体测试板行业政策（Policy）环境分析

- 2.2.1 中国半导体测试板行业监管体系及机构介绍
 - （1）中国半导体测试板行业主管部门
 - （2）中国半导体测试板行业自律组织
- 2.2.2 中国半导体测试板行业标准体系建设现状（国家/地方/行业/团体/企业标准）
 - （1）中国半导体测试板标准体系建设
 - （2）中国半导体测试板现行标准汇总
 - （3）中国半导体测试板即将实施标准
 - （4）中国半导体测试板重点标准解读
- 2.2.3 国家层面半导体测试板行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）
 - （1）国家层面半导体测试板行业政策汇总及解读
 - （2）国家层面半导体测试板行业规划汇总及解读
- 2.2.4 31省市半导体测试板行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）
 - （1）31省市半导体测试板行业政策规划汇总

- (2) 31省市半导体测试板行业发展目标解读
- 2.2.5 国家重点规划/政策对半导体测试板行业发展的影响
- 2.2.6 政策环境对半导体测试板行业发展的影响总结
- 第3章：全球半导体测试板行业发展现状调研及市场趋势洞察**
- 3.1 全球半导体测试板行业发展历程介绍
- 3.2 全球半导体测试板行业发展环境分析（技术、政策等）
- 3.3 全球半导体测试板行业发展现状分析
- 3.4 全球半导体测试板行业市场规模体量及趋势前景预判
- 3.4.1 全球半导体测试板行业市场规模体量
- 3.4.2 全球半导体测试板行业市场前景预测（未来5年数据预测）
- 3.4.3 全球半导体测试板行业发展趋势预判（疫情影响等）
- 3.5 全球半导体测试板行业区域发展格局及重点区域市场研究
- 3.5.1 全球半导体测试板行业区域发展格局
- 3.5.2 全球半导体测试板重点区域市场分析
- 3.6 全球半导体测试板行业市场竞争格局
- 3.6.1 全球半导体测试板企业兼并重组状况
- 3.6.2 全球半导体测试板行业市场竞争格局
- 3.7 全球半导体测试板行业发展经验借鉴
- 第4章：中国半导体测试板行业市场供需状况及发展痛点分析**
- 4.1 中国半导体测试板行业发展历程
- 4.2 中国半导体测试板行业市场特性
- 4.3 中国半导体测试板行业市场主体类型及入场方式
- 4.3.1 中国半导体测试板行业市场主体类型（投资/经营/服务/中介主体）
- 4.3.2 中国半导体测试板行业企业入场方式（自建/并购/战略合作等）
- 4.4 中国半导体测试板行业企业数量
- 4.5 中国半导体测试板行业市场供需状况
- 4.5.1 中国半导体测试板行业市场供给能力
- 4.5.2 中国半导体测试板行业市场需求状况
- 4.6 中国半导体测试板供需平衡状态及行情走势
- 4.6.1 中国半导体测试板行业供需平衡状态
- 4.6.2 中国半导体测试板行业市场行情走势
- 4.7 中国半导体测试板行业招投标市场解读
- 4.7.1 中国半导体测试板行业招投标信息汇总
- 4.7.2 中国半导体测试板行业招投标信息解读
- 4.8 中国半导体测试板行业市场规模体量测算
- 4.9 中国半导体测试板行业市场发展痛点分析
- 第5章：中国半导体测试板行业市场竞争状况及融资并购分析**
- 5.1 中国半导体测试板行业市场竞争布局状况
- 5.1.1 中国半导体测试板行业竞争者入场进程
- 5.1.2 中国半导体测试板行业竞争者省市分布热力图
- 5.1.3 中国半导体测试板行业竞争者战略布局状况
- 5.2 中国半导体测试板行业市场竞争格局分析
- 5.2.1 中国半导体测试板行业企业竞争集群分布
- 5.2.2 中国半导体测试板行业企业竞争格局分析
- 5.2.3 中国半导体测试板行业市场集中度分析
- 5.3 中国半导体测试板行业国产替代布局与发展
- 5.4 中国半导体测试板行业波特五力模型分析
- 5.4.1 中国半导体测试板行业供应商的议价能力
- 5.4.2 中国半导体测试板行业消费者的议价能力
- 5.4.3 中国半导体测试板行业新进入者威胁
- 5.4.4 中国半导体测试板行业替代品威胁
- 5.4.5 中国半导体测试板行业现有企业竞争
- 5.4.6 中国半导体测试板行业竞争状态总结
- 5.5 中国半导体测试板行业投融资、兼并与重组状况
- 5.5.1 中国半导体测试板行业投融资发展状况
- (1) 中国半导体测试板行业投融资概述
- 1) 半导体测试板行业资金来源
- 2) 半导体测试板行业投融资主体构成
- (2) 中国半导体测试板行业投融资事件汇总

- (3) 中国半导体测试板行业投融资规模
- (4) 中国半导体测试板行业投融资解析（热门领域/融资轮次/对外投资等）
- (5) 中国半导体测试板行业投融资趋势预测
- 5.5.2 中国半导体测试板行业兼并与重组状况
 - (1) 中国半导体测试板行业兼并与重组事件汇总
 - (2) 中国半导体测试板行业兼并与重组类型及动因
 - (3) 中国半导体测试板行业兼并与重组案例分析
 - (4) 中国半导体测试板行业兼并与重组趋势预判
- 第6章：中国半导体测试板产业链全景及配套产业发展**
 - 6.1 中国半导体测试板产业结构属性（产业链）分析**
 - 6.1.1 中国半导体测试板产业链结构梳理
 - 6.1.2 中国半导体测试板产业链生态图谱
 - 6.1.3 中国半导体测试板产业链区域热力图
 - 6.2 中国半导体测试板产业价值属性（价值链）分析**
 - 6.2.1 中国半导体测试板行业成本结构分析
 - 6.2.2 中国半导体测试板价格传导机制分析
 - 6.2.3 中国半导体测试板行业价值链分析
 - 6.3 中国半导体测试板原材料市场分析**
 - 6.3.1 半导体测试板原材料概述
 - 6.3.2 中国半导体测试板原材料市场现状
 - 6.3.3 中国半导体测试板原材料发展趋势
 - 6.4 配套产业布局对半导体测试板行业发展的影响总结**
- 第7章：中国半导体测试板行业细分产品市场发展状况**
 - 7.1 中国半导体测试板行业细分产品市场结构**
 - 7.2 中国半导体测试板细分市场分析：探针卡**
 - 7.2.1 探针卡市场概述
 - 7.2.2 探针卡市场发展现状
 - 7.2.3 探针卡发展趋势前景
 - 7.3 中国半导体测试板细分市场分析：测试负载板（Load Board）**
 - 7.3.1 测试负载板（Load Board）市场概述
 - 7.3.2 测试负载板（Load Board）市场发展现状
 - 7.3.3 测试负载板（Load Board）市场趋势前景
 - 7.4 中国半导体测试板细分市场分析：老化测试板（Burn in Board）**
 - 7.4.1 老化测试板（Burn in Board）市场概述
 - 7.4.2 老化测试板（Burn in Board）市场发展现状
 - 7.4.3 老化测试板（Burn in Board）市场趋势前景
 - 7.5 中国半导体测试板行业细分市场战略地位分析**
- 第8章：中国半导体测试板行业应用市场需求状况**
 - 8.1 中国半导体测试板应用场景/行业领域分布
 - 8.2 中国集成电路（IC）行业发展现状
 - 8.3 中国集成电路（IC）行业发展趋势
 - 8.4 中国集成电路（IC）细分市场发展现状
 - 8.5 中国集成电路（IC）封装测试市场分析
 - 8.6 中国集成电路（IC）重点应用领域分析
 - 8.7 半导体测试板需求其他影响因素分析
- 第9章：半导体测试板企业发展及业务布局案例研究**
 - 9.1 半导体测试板企业发展及业务布局梳理与对比
 - 9.2 半导体测试板企业发展及业务布局案例分析（不分先后，可定制）
 - 9.2.1 FormFactor 美国
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - 1) 企业发展历程
 - 2) 企业基本信息
 - 3) 企业股权结构
 - (2) 企业业务架构及经营情况
 - 1) 企业整体业务架构
 - 2) 企业整体经营情况
 - (3) 企业半导体测试板布局及发展状况
 - (4) 企业半导体测试板最新布局动向追踪
 - (5) 企业半导体测试板布局与发展优劣势分析

- 9.2.2 Technoprobe 意大利
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - 1) 企业发展历程
 - 2) 企业基本信息
 - 3) 企业股权结构
 - (2) 企业业务架构及经营情况
 - 1) 企业整体业务架构
 - 2) 企业整体经营情况
 - (3) 企业半导体测试板布局及发展状况
 - (4) 企业半导体测试板最新布局动向追踪
 - (5) 企业半导体测试板布局与发展优劣势分析
- 9.2.3 MJC 日本
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - 1) 企业发展历程
 - 2) 企业基本信息
 - 3) 企业股权结构
 - (2) 企业业务架构及经营情况
 - 1) 企业整体业务架构
 - 2) 企业整体经营情况
 - (3) 企业半导体测试板布局及发展状况
 - (4) 企业半导体测试板最新布局动向追踪
 - (5) 企业半导体测试板布局与发展优劣势分析
- 9.2.4 Korea Instrument 韩国
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - 1) 企业发展历程
 - 2) 企业基本信息
 - 3) 企业股权结构
 - (2) 企业业务架构及经营情况
 - 1) 企业整体业务架构
 - 2) 企业整体经营情况
 - (3) 企业半导体测试板布局及发展状况
 - (4) 企业半导体测试板最新布局动向追踪
 - (5) 企业半导体测试板布局与发展优劣势分析
- 9.2.5 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - 1) 企业发展历程
 - 2) 企业基本信息
 - 3) 企业股权结构
 - (2) 企业业务架构及经营情况
 - 1) 企业整体业务架构
 - 2) 企业整体经营情况
 - (3) 企业半导体测试板布局及发展状况
 - (4) 企业半导体测试板最新布局动向追踪
 - (5) 企业半导体测试板布局与发展优劣势分析
- 9.2.6 上海泽丰半导体科技有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - 1) 企业发展历程
 - 2) 企业基本信息
 - 3) 企业股权结构
 - (2) 企业业务架构及经营情况
 - 1) 企业整体业务架构
 - 2) 企业整体经营情况
 - (3) 企业半导体测试板布局及发展状况
 - (4) 企业半导体测试板最新布局动向追踪
 - (5) 企业半导体测试板布局与发展优劣势分析
- 9.2.7 强一半导体（苏州）股份有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - 1) 企业发展历程
 - 2) 企业基本信息

- 3) 企业股权结构
- (2) 企业业务架构及经营情况
 - 1) 企业整体业务架构
 - 2) 企业整体经营情况
 - (3) 企业半导体测试板布局及发展状况
 - (4) 企业半导体测试板最新布局动向追踪
 - (5) 企业半导体测试板布局与发展优劣势分析
- 9.2.8 四会富仕电子科技有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - 1) 企业发展历程
 - 2) 企业基本信息
 - 3) 企业股权结构
 - (2) 企业业务架构及经营情况
 - 1) 企业整体业务架构
 - 2) 企业整体经营情况
 - (3) 企业半导体测试板布局及发展状况
 - (4) 企业半导体测试板最新布局动向追踪
 - (5) 企业半导体测试板布局与发展优劣势分析
- 9.2.9 旺矽科技 (MPI)
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - 1) 企业发展历程
 - 2) 企业基本信息
 - 3) 企业股权结构
 - (2) 企业业务架构及经营情况
 - 1) 企业整体业务架构
 - 2) 企业整体经营情况
 - (3) 企业半导体测试板布局及发展状况
 - (4) 企业半导体测试板最新布局动向追踪
 - (5) 企业半导体测试板布局与发展优劣势分析
- 9.2.10 中华精测科技股份有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - 1) 企业发展历程
 - 2) 企业基本信息
 - 3) 企业股权结构
 - (2) 企业业务架构及经营情况
 - 1) 企业整体业务架构
 - 2) 企业整体经营情况
 - (3) 企业半导体测试板布局及发展状况
 - (4) 企业半导体测试板最新布局动向追踪
 - (5) 企业半导体测试板布局与发展优劣势分析
- 第10章：中国半导体测试板行业市场前景预测及发展趋势预判**
 - 10.1 中国半导体测试板行业SWOT分析
 - 10.2 中国半导体测试板行业发展潜力评估
 - 10.3 中国半导体测试板行业发展前景预测（未来5年数据预测）
 - 10.4 中国半导体测试板行业发展趋势预判（疫情影响等）
- 第11章：中国半导体测试板行业投资战略规划策略及发展建议**
 - 11.1 中国半导体测试板行业进入与退出壁垒
 - 11.1.1 半导体测试板行业进入壁垒分析
 - 11.1.2 半导体测试板行业退出壁垒分析
 - 11.2 中国半导体测试板行业投资风险预警
 - 11.3 中国半导体测试板行业投资价值评估
 - 11.4 中国半导体测试板行业投资机会分析
 - 11.4.1 半导体测试板行业产业链薄弱环节投资机会
 - 11.4.2 半导体测试板行业细分领域投资机会
 - 11.4.3 半导体测试板行业区域市场投资机会
 - 11.4.4 半导体测试板产业空白点投资机会
 - 11.5 中国半导体测试板行业投资策略与建议
 - 11.6 中国半导体测试板行业可持续发展建议

图表目录

- 图表1: 《国民经济行业分类与代码》中集成电路（IC）行业归属
- 图表2: 半导体测试板的界定
- 图表3: 半导体测试板的分类
- 图表4: 半导体测试板专业术语说明
- 图表5: 本报告研究范围界定
- 图表6: 本报告权威数据资料来源汇总
- 图表7: 本报告的主要研究方法及统计标准说明
- 图表8: 中国半导体测试板行业工艺类型/技术路线分析
- 图表9: 中国半导体测试板行业关键技术分析
- 图表10: 中国半导体测试板行业科研投入状况
- 图表11: 中国半导体测试板行业专利申请
- 图表12: 中国半导体测试板行业专利公开
- 图表13: 中国半导体测试板行业热门申请人
- 图表14: 中国半导体测试板行业热门技术
- 图表15: 技术环境对半导体测试板行业发展的影响总结
- 图表16: 中国半导体测试板行业监管体系
- 图表17: 中国半导体测试板行业主管部门
- 图表18: 中国半导体测试板行业自律组织
- 图表19: 中国半导体测试板标准体系建设
- 图表20: 中国半导体测试板现行标准汇总
- 图表21: 中国半导体测试板即将实施标准
- 图表22: 中国半导体测试板重点标准解读
- 图表23: 截至2022年中国半导体测试板行业发展政策汇总
- 图表24: 截至2022年中国半导体测试板行业发展规划汇总
- 图表25: 31省市半导体测试板行业政策规划汇总
- 图表26: 31省市半导体测试板行业发展目标解读
- 图表27: 国家“十四五”规划对半导体测试板行业的影响分析
- 图表28: 政策环境对半导体测试板行业发展的影响总结
- 图表29: 全球半导体测试板行业发展历程
- 图表30: 全球半导体测试板行业发展环境概况
- 图表31: 全球半导体测试板行业技术环境
- 图表32: 全球半导体测试板行业政策环境
- 图表33: 全球半导体测试板行业市场规模体量分析
- 图表34: 2023-2028年全球半导体测试板行业市场前景预测
- 图表35: 全球半导体测试板行业发展趋势预判
- 图表36: 全球半导体测试板行业区域发展格局
- 图表37: 全球半导体测试板行业重点区域市场分析
- 图表38: 全球半导体测试板企业兼并重组状况
- 图表39: 全球半导体测试板行业市场竞争格局
- 图表40: 全球半导体测试板行业发展经验借鉴
- 图表41: 中国半导体测试板行业发展历程
- 图表42: 中国半导体测试板行业市场主体类型
- 图表43: 中国半导体测试板行业企业入场方式
- 图表44: 中国半导体测试板行业历年新增企业数量
- 图表45: 中国半导体测试板行业市场供给能力分析
- 图表46: 中国半导体测试板行业市场供给水平分析
- 图表47: 中国半导体测试板行业市场饱和度分析
- 图表48: 中国半导体测试板行业市场需求状况
- 图表49: 中国半导体测试板行业市场行情走势分析
- 图表50: 中国半导体测试板行业主要招投标规模
- 图表51: 中国半导体测试板行业主要招投标区域特征
- 图表52: 中国半导体测试板行业招标主体特征
- 图表53: 中国半导体测试板行业中标主体特征

- 图表54: 中国半导体测试板行业市场规模体量测算
图表55: 中国半导体测试板行业市场发展痛点分析
图表56: 中国半导体测试板行业竞争者入场进程
图表57: 中国半导体测试板行业竞争者区域分布热力图
图表58: 中国半导体测试板行业竞争者发展战略布局状况
图表59: 中国半导体测试板行业企业战略集群状况
图表60: 中国半导体测试板行业企业竞争格局分析
图表61: 中国半导体测试板行业市场竞争态势
图表62: 中国半导体测试板行业市场集中度分析
图表63: 中国半导体测试板行业国产替代布局状况
图表64: 中国半导体测试板行业供应商的议价能力
图表65: 中国半导体测试板行业消费者的议价能力
图表66: 中国半导体测试板行业新进入者威胁
图表67: 中国半导体测试板行业替代品威胁
图表68: 中国半导体测试板行业现有企业竞争
图表69: 中国半导体测试板行业竞争状态总结
图表70: 中国半导体测试板行业资金来源
图表71: 中国半导体测试板行业投融资主体
图表72: 中国半导体测试板行业投融资事件汇总
图表73: 中国半导体测试板行业投融资规模
图表74: 中国半导体测试板行业投融资发展状况
图表75: 中国半导体测试板行业兼并与重组事件汇总
图表76: 中国半导体测试板行业兼并与重组动因分析
图表77: 中国半导体测试板行业兼并与重组案例分析
图表78: 中国半导体测试板行业兼并与重组趋势预判
图表79: 中国半导体测试板产业链结构
图表80: 中国半导体测试板产业链生态图谱
图表81: 中国半导体测试板产业链区域热力图
图表82: 中国半导体测试板行业成本结构分析
图表83: 中国半导体测试板行业价值链分析
图表84: 中国半导体测试板行业细分市场结构
图表85: 中国探针卡市场分析
图表86: 中国测试负载板 (Load Board) 市场分析
图表87: 中国老化测试板 (Burn in Board) 市场分析
图表88: 中国半导体测试板行业细分市场战略地位分析
图表89: 中国半导体测试板应用场景分布
图表90: 半导体测试板企业发展及业务布局梳理及对比
图表91: FormFactor 美国发展历程
图表92: FormFactor 美国基本信息表
图表93: FormFactor 美国股权穿透图
图表94: FormFactor 美国业务架构及经营情况
图表95: FormFactor 美国半导体测试板布局与发展优劣势
图表96: Technoprobe 意大利发展历程
图表97: Technoprobe 意大利基本信息表
图表98: Technoprobe 意大利股权穿透图
图表99: Technoprobe 意大利业务架构及经营情况
图表100: Technoprobe 意大利半导体测试板布局与发展优劣势
图表101: MJC 日本发展历程
图表102: MJC 日本基本信息表
图表103: MJC 日本股权穿透图
图表104: MJC 日本业务架构及经营情况
图表105: MJC 日本半导体测试板布局与发展优劣势
图表106: Korea Instrument 韩国发展历程
图表107: Korea Instrument 韩国基本信息表
图表108: Korea Instrument 韩国股权穿透图
图表109: Korea Instrument 韩国业务架构及经营情况
图表110: Korea Instrument 韩国半导体测试板布局与发展优劣势
图表111: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司发展历程
图表112: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司基本信息表

图表113: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股权穿透图
图表114: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司业务架构及经营情况
图表115: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司半导体测试板布局与发展优劣势
图表116: 上海泽丰半导体科技有限公司发展历程
图表117: 上海泽丰半导体科技有限公司基本信息表
图表118: 上海泽丰半导体科技有限公司股权穿透图
图表119: 上海泽丰半导体科技有限公司业务架构及经营情况
图表120: 上海泽丰半导体科技有限公司半导体测试板布局与发展优劣势
略.....完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！